２０２５年 4月 25日

委員各位殿

一般社団法人 溶接学会
マイクロ接合研究委員会
委員長 福本信次
（公印省略）

マイクロ接合研究委員会 開催通知

第149回マイクロ接合研究委員会を下記の通り開催致しますので、万障お繰り合せの上ご出席下さいますようご案内申し上げます。

出欠は5月16 日（金）までにお知らせ下さい

1. 日 時　　2025年 5月 23日（金） 10:30～16:35

2. 場 所　　大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 912+913会議室
東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 11 号 日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階

3.幹事会のご案内
幹事会を 12:00～開催いたしますので、幹事または代理の方はご出席下さいますようお願い申し上げます。会場は 911 会議室です。

【出欠・事務関連の連絡先】
一般社団法人溶接学会 事務局 木暮
E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp　TEL：03-5825-4073

第149回マイクロ接合研究委員会
プ ロ グ ラ ム

日 時: 2025年 5月 23日(金) 10:30～16:35

場 所: 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913+912 会議室(東京 日本橋)

時 間	題 目	講 演 者
司 会 神原淳 (大阪大学)		
10:30～11:15	Mate2025 受賞講演 『熱-構造-音響解析による Al 板の 超音波接合挙動の予測研究』 (資料番号MJ-876-2025)	(株)東芝 ○久保悠, 相澤隆博, 篠原勇人, 東條啓
11:15～12:00	『インライン SEM によるハイブリッド接合向け Cu パッドのナノトポグラフィ評価技術』 (資料番号MJ-877-2025)	(株)日立製作所 ○大崎真由香 (株)日立ハイテク 笠井啓晃, 蓮見和久, 三瀬信行, 田中麻紀
12:00～13:00	昼 食 休 憩	
13:00～13:10	委 員 会 議 事	
13:10～13:20	M J 賞 表 彰 式	
司 会 瀬知啓久 (東京ブレイズ株式会社)		
13:20～14:05	『電子実装接合部に用いられる 銅バンプ・銅薄膜の変形挙動予測の試み』 (資料番号MJ-878-2025)	鹿児島大学 ○小金丸正明, 宇都瑛生, 藤掛翔平, 木村悠人 パナソニック ホールディングス(株) 生田敬子, 櫻井大輔, 持田篤範 鹿児島大学 池田徹
14:05～14:50	『パワー半導体パッケージにおける はんだ接合ボイド変動がパワーサイクル寿命に及ぼす影響』 (資料番号MJ-879-2025)	シーマ電子(株) ○小野寺浩, 浅利太輔, 磯野浩 近畿大学 宍戸信之 九州大学 齋藤渉
14:50～15:05	休 憩	
司 会 加藤薫子 (株式会社日立製作所)		
15:05～15:50	『高信頼性シリコンブリッジパッケージに向けた 接合技術及び封止技術』 (資料番号MJ-880-2025)	日本アイ・ビー・エム(株) ○丸島千波
15:50～16:35	『Bumpless Build Cube (BBCube^{TM}) 3D: WOW, COW を用いたヘテロジニアス 3 次元実装技術』 (資料番号MJ-881-2025)	東京科学大学 総合研究院 ○中條徳男

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

4.配付資料について

当日の配布資料は委員会開催前にダウンロードシステムを利用し皆様へご送付致します。
開催当日までにご自身にて印刷を行っていただきご準備のうえご参加をお願いいたします。
✓配付資料は各自でご持参ください。会場に紙資料のご用意はございません。

（案内図）

アクセス

・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6出口より徒歩3分
・ＪＲ総武本線「新日本橋」駅　５番出口より徒歩2分
・ＪＲ各線「神田」駅　南口より徒歩 11 分
・ＪＲ各線「東京」駅　新日本橋口より徒歩 17 分